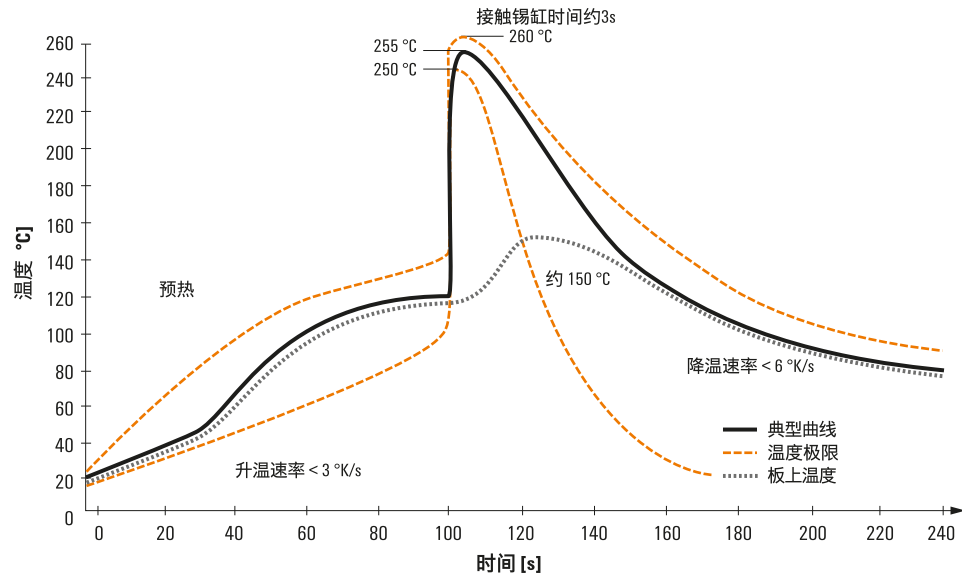


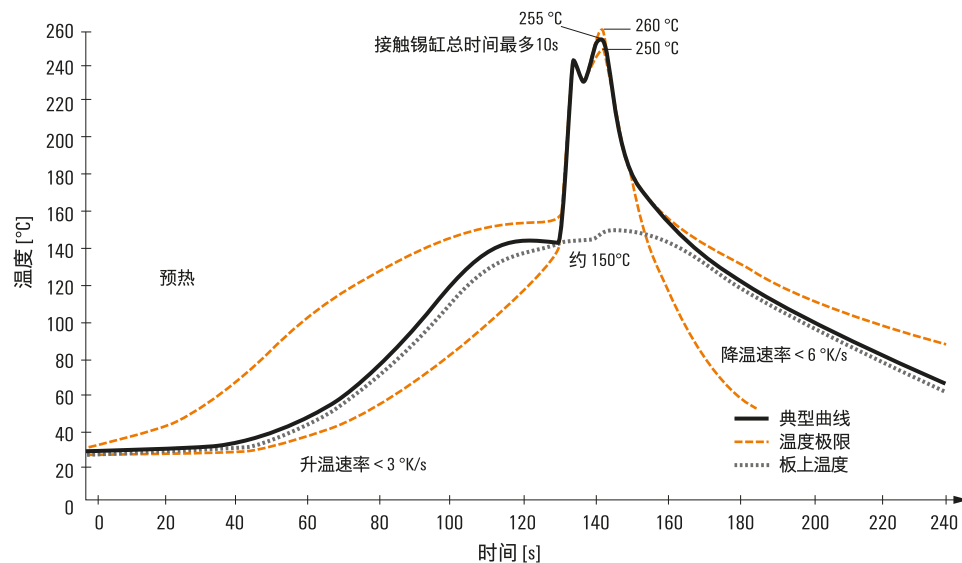
推荐的波峰焊接曲线

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

单波峰：



双波峰：



波峰焊接曲线

接线端子需要按照DIN EN / IEC 61760-1标准进行焊接加工，此处推荐的两种常用的焊接曲线都是魏德米勒PCB端子和接插件验证过的。

当为您的产品选择合适的波峰焊曲线时还需要考虑到如下几点：

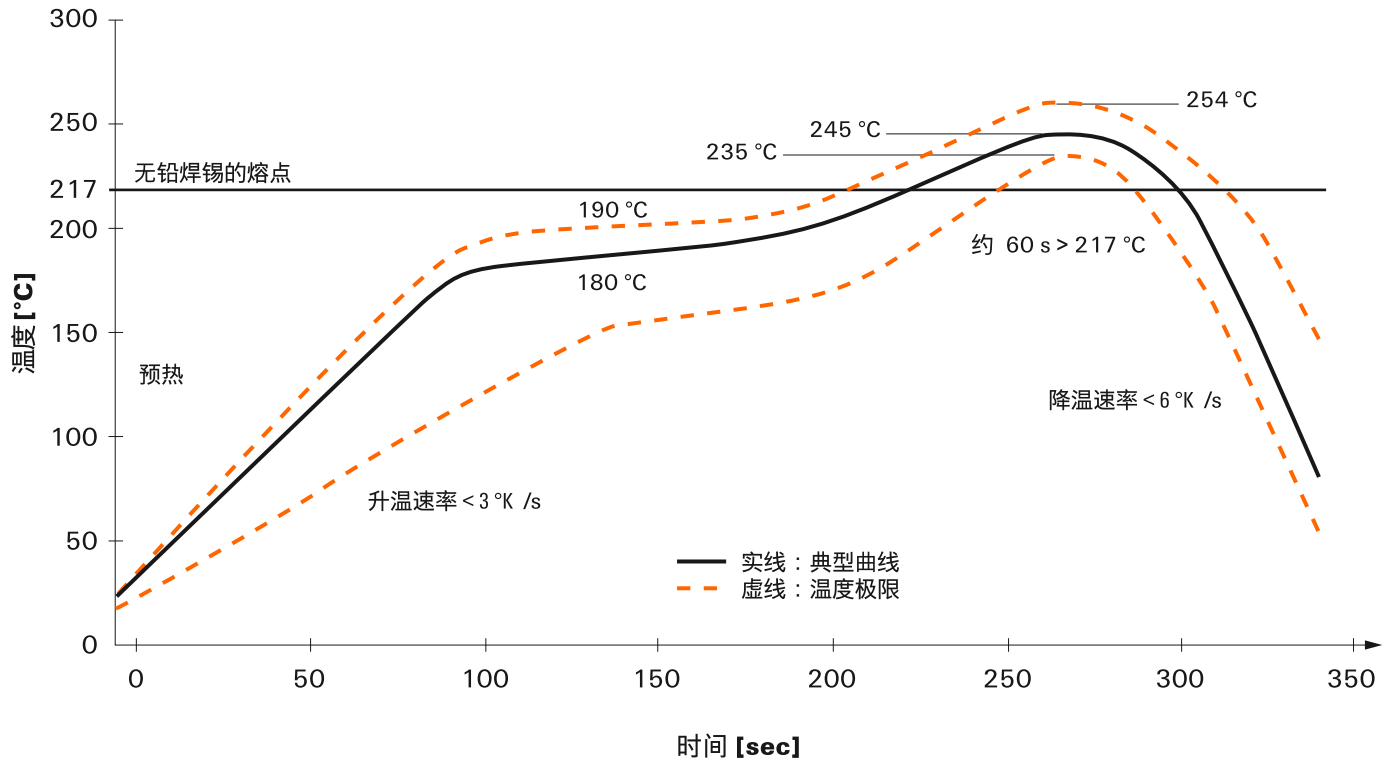
- PCB板的厚度
- Cu在各层中的占比
- 单面或双面装配
- 产品类别
- 升温 and 降温的速率

单、双波峰焊接曲线都对焊接范围作了推荐，包含最大焊接温度是260°C。实际应用中，最高焊接温度通常都是远低于以上曲线。

我们保留技术更改的权利。

推荐的回流焊接曲线

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



回流焊接曲线

为SMT穿孔回流/SMD表贴焊提供完美的焊接曲线是SMT制造领域经常谈论的话题，但是正确答案不止一个：温度时间曲线与焊锡的焊接特性相关，同时也与器件的最大承载数量有关。

如下参数我们需要考虑：

- 预热时间
- 最大温度
- 维持在熔点以上的时间
- 降温时间
- 最大升温速率
- 最大降温速率

我们推荐的典型焊接曲线是关联的过程限值相关的。在预热阶段，元器件和PCB板已经为焊接阶段做好顺利的准备。升温速率正常应该 $\leq 3\text{K/s}$ ，同时锡膏要处于融化状态。温度高于锡膏的熔点 217°C 时，锡膏处于液态，器件和PCB板开始联接。 $245^\circ\text{C} \sim 254^\circ\text{C}$ 的最高温度时间需要保持 $10 \sim 40$ 秒的时间。降温阶段，速率 $\geq 6\text{K/s}$ 时，焊锡变硬，PCB板和元器件冷却下来，也可避免冷却裂缝。